

2026년

지능형 반도체 시험분석·성능검증 지원 지원기업 모집 공고



『2026년 지능형 반도체 시험분석·성능검증 지원』 모집 공고

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원에서는 국내 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 이를 적용한 제품의 시험분석·성능검증을 지원하여 기업의 기술개발 성과 확산을 도모하고자 하오니 기업의 많은 신청 바랍니다.

2026년 4월 17일

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원장

1. 지원계획

1. 추진목적

- 국내 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 이를 적용한 모듈, 보드, 제품의 시험분석·성능검증을 지원하여, 상용화 기반 마련과 글로벌 경쟁력 확보 지원

2. 지원개요

- 지원사업 : 2026년 지능형 반도체 시험분석·성능검증 지원
- 지원기간 : 2026년 6월 1일 ~ 11월 2일 (5개월)
- 지원범위 : 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 이를 적용한 모듈, 보드, 제품의 시험분석 및 성능검증(인증)으로 기업에서 자율적으로 제시한 2개 이내의 제품
- 지원방식 : 직접(서비스)지원, 간접(비용)지원
 - * 직접(서비스)지원 : 지원기관의 시설, 장비, 인력 등 지원 인프라를 활용한 서비스 지원
 - * 간접(비용)지원 : 과제종료 후 지원기업과 계(확)약한 외부 용역/의뢰 기업에게 이용 비용 지급
- 지원한도 : 기업(과제)당 최대 1,000만원
 - * 부가가치세 제외
- 선정규모 : 10개 기업(과제) 내외
 - * 선정기업(과제) 수는 총 지원예산 범위 내에서 과제별 지원금액을 고려하여 결정

3. 지원내용

□ 지원항목 및 내용

- 과제별 지원한도 내에서 신청하되, 시험분석 서비스 지원은 필수 선택

지원항목	지원내용	지원방식	지원한도																									
시험분석 서비스	<p>- [필수] 기술원이 보유한 시험분석 장비와 전문인력을 통한 시험분석 지원</p> <p>※ 시험분석 서비스 가능 항목 예시</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>시험/검사 종류</th> <th>시험 장비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BGA 납땜 품질 검사</td> <td rowspan="5">스마트 센서 검사 시스템 (X-eye SF160ER)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SMD 부품 접합 검사</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>와이어 본딩 검사</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>다이 어태치/에폭시 분석</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>고밀도 PCB 내부 관찰</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>모듈/센서 패키지 내부 구조 파악</td> <td rowspan="5">전파시험(EMC) 장비</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>AXI 기반 자동 검사</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EMI(전자파 간섭) 시험</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EMS(전자파 내성) 시험</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ESD(정전기 방전) 시험</td> </tr> </tbody> </table>	No.	시험/검사 종류	시험 장비	1	BGA 납땜 품질 검사	스마트 센서 검사 시스템 (X-eye SF160ER)	2	SMD 부품 접합 검사	3	와이어 본딩 검사	4	다이 어태치/에폭시 분석	5	고밀도 PCB 내부 관찰	6	모듈/센서 패키지 내부 구조 파악	전파시험(EMC) 장비	7	AXI 기반 자동 검사	8	EMI(전자파 간섭) 시험	9	EMS(전자파 내성) 시험	10	ESD(정전기 방전) 시험	직접지원 (서비스)	무상
No.	시험/검사 종류	시험 장비																										
1	BGA 납땜 품질 검사	스마트 센서 검사 시스템 (X-eye SF160ER)																										
2	SMD 부품 접합 검사																											
3	와이어 본딩 검사																											
4	다이 어태치/에폭시 분석																											
5	고밀도 PCB 내부 관찰																											
6	모듈/센서 패키지 내부 구조 파악	전파시험(EMC) 장비																										
7	AXI 기반 자동 검사																											
8	EMI(전자파 간섭) 시험																											
9	EMS(전자파 내성) 시험																											
10	ESD(정전기 방전) 시험																											
시험분석 성능검증	- 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 모듈, 보드, 제품의 시험분석 및 성능검증(인증) 지원	간접지원 (비용)	최대 10,000 천원																									

4. 신청자격

□ 지원대상

- 비수도권 (서울, 경기, 해외 제외) 내 본사, 지사, 연구소 중 1개 이상 소재하고 있는 **국내 팹리스 전문 중소기업¹⁾ 및 중견기업²⁾**
- 비수도권 소재 팹리스 중소·중견기업과 수요기업의 컨소시엄*
 - * 컨소시엄으로 신청하는 경우에도 지원 방식 및 한도는 동일하며 신청 주체는 팹리스 중소·중견기업이어야 함

□ 지원제외 대상

- 지원받고자 하는 제품이 타 정부·지직접·기관에서 동일 지원항목의 지원을 받았거나, 지원을 받고 있는 경우 (중복 지원에 해당)
- 접수마감일 현재, 대표자와 책임자가 참여제한 등의 제재를 받고 있는 경우
- 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우
- 신청일 현재 휴업 또는 폐업된 경우
- 최근 2년 연속 결산 재무제표상 부채비율이 500% 이상 또는 유동비율이 50% 이하인 기업 및 최근년도 결산 기준 자본 전액 잠식 상태에 있는 경우 (설립 후 7년 미경과 기업은 적용하지 않음)
 - * 설립일은 사업자등록증 상 개업년월일을 기준으로 함
- 지원제외 대상 여부는 동일한 조건을 기준으로 선정평가위원회에서 최종 판단

□ 우대사항

우대조건	가점
<ul style="list-style-type: none"> · 지능형반도체개발지원센터 입주기업 - 제출서류 : 없음 (별도 확인) 	5점

1) 중소기업기본법 제2조 및 중소기업법시행령 제3조 (중소기업의 범위) 참조

2) 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 참조

II. 접수 및 평가

1. 지원신청서 접수

□ 공모 및 접수기간 : 2026년 4월 17일 ~ 5월 8일 (21일간)

□ 지원신청

• 접수방법 : 제출서류를 모두 구비하여 이메일 (cisdaegu@iact.or.kr) 제출

* 마감일 16시 이전 도착분에 한하며, 제출 후 필히 '접수 확인 메일' 확인 (접수 후 1시간 이내 확인 메일 미수신시 미접수 상태이므로 접수 여부 유선 문의)

• 제출서류

순번	구분	제출서류	수량	유형	비고
1	필수	지원신청서	1부	*.hwp	지정서식
2		참여제한정보 검색결과 (별첨 1. 참조)	1부	스캔본 (*pdf)	책임자
3		사업자등록증	1부		
4		최근 2개년도 기업 재무제표	1부		
5		국세 및 지방세 완납 증명서	1부		
6		지원금 산출 근거 (견적서 등)	각 1부		
7	선택	기타 추가 증빙서류			

* 사본은 원본대조필 날인 필수

• 서류제출 시 유의사항

- 제출서류

㉠ 제출서류는 반드시 첨부된 지정서식을 사용하여야 하며, 누락되는 일이 없도록 제출 이전 필히 점검 (지정서식 이외 서식 사용, 서식 임의 변경, 제출서류 누락의 경우 선정평가 대상에서 제외)

㉡ **신청서의 성실한 작성도 평가항목**이므로 **예시 및 작성요령**에서 제시한 사항 (**파란글씨**)을 참고하여 성의있게 작성

㉢ 제출서류가 위·변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출할 것

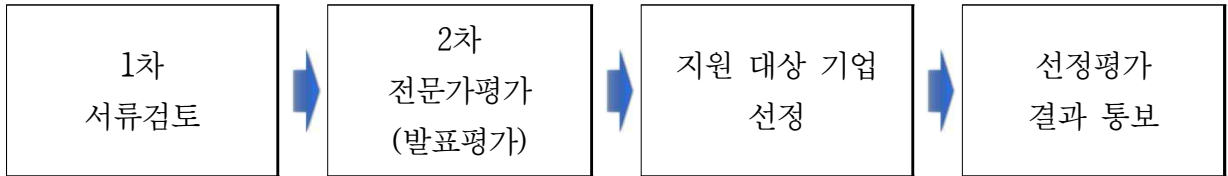
㉣ '기타 추가 증빙서류' (7번) 는 본 과제와 관련하여 추가로 제출하고자 하는 서류가 있을 경우만 제출 (ex. 소재지 증명, 관련 특허증, 수상이력 등)

㉤ 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입 (ex. 3_사업자등록증 ((주)침정원).pdf)

2. 선정평가

□ 평가절차

- 지능형반도체개발지원센터 직접 1차 서류검토 이후 각 분야별 전문가로 구성된 선정평가위원회의 2차 전문가평가를 거쳐 신규 지원 대상 기업 선정



* 필요한 경우 평가절차를 변경하거나 추가할 수 있으며 평가시간 및 결과는 개별 통보

□ 평가기준

- **(1차 서류검토)** 제출된 서류로 신청기업의 적합성 여부 판단

평가항목	평가내용	평가지표
신청자격 적합성	신청서류 적합성*	신청서의 오류 및 성실작성 여부 제출서류의 누락 및 부실 여부
	신청자격 적합성	지원 및 제외 대상 해당 여부

* 작성 요청사항과의 부합·구체적 기술 정도 등을 고려하여 누락 및 부실 (2차 전문가평가의 평가지표에 따른 평가가 불가할 정도) 작성 여부 정성적 판단

- **(2차 전문가평가)** 발표평가를 통해 과제수행 타당성, 수행계획 우수성, 성과창출 가능성을 종합적으로 평가하여 신규 지원 대상 기업 선정

평가항목	평가내용	평가지표
과제수행 타당성	수행역량 및 지원 필요성	신청기업의 보유 핵심역량 (기술력, 마케팅 등)
		지원의 합리적 필요정도
수행계획 우수성	제품 우수성	제품의 기능적 효용성 및 혁신성
		제품의 사업성 (시장규모, 수익구조 등)
성과창출 가능성	수행계획 적절성	시험분석 및 성능검증 계획의 명확성 및 구체성
	사업비 사용 계획	사업비 편성 및 산출의 적절성
성과창출 가능성	성공적인 추진 가능성	설정 성과목표의 현실성 및 달성 가능성
		신청기업의 추진의지

□ 선정평가 결과 발표

- 선정평가 결과는 지원신청서에 기재된 담당자의 연락처와 e-mail을 통해 개별 통보하며, 평가결과는 원칙적으로 공개하지 않음

공모 및 신청 문의

- 담당자 : 김태연 연구원
- 연락처
 - 전 화 : 053-219-0343 (10:00~17:00)
 - 이 메 일 : cisdaegu@iact.or.kr

별첨 1. 제재정보 조회 방법

- ① 국가R&D사업관리서비스(https://www.ntis.go.kr) 회원가입 또는 로그인 (개인별)
- ② ‘과제참여·관리-제재정보조회’ 에서 대표자 및 책임자의 제재정보 조회

The screenshot shows the NTIS homepage with the '과제참여·관리' menu highlighted in a red box. To the right, the '본인제재확인' page is displayed, showing '현재제재 0건' and '과거제재 0건' with '상세보기' buttons. A red box highlights the '현재제재 0건' button.

- ③ 조회결과페이지 출력 (소속기관명과 신청기업이 일치해 함)

The screenshot shows the '현재 제재정보' search results page. It includes a '도움말' section, a '검색결과 0건' section with an empty table, and a '제재정보 확인시 다운로드' button highlighted in a red box.

선명	성명	생년월일	성별	국가연구자번호	소속기관명	제재건수
	김동진		남자		첨단정보통신융합산업기술원	NTIS 제재정보 조회 결과 국가연구개발사업의 제재정보 이력이 없습니다.

<제재정보 조회페이지>

The screenshot shows a table titled '참여제한 정보 검색결과' with search criteria and results.

참여제한 정보 검색결과		
검색 조건	성명	김동진
	생년월일	
	성별	남자
	국가연구자번호	
	소속기관명	첨단정보통신융합산업기술원
검색 범위	제재예정, 제재중	
검색 일시	2022년 02월 21일	
검색 결과	0 건	
세부 검색 결과		
NTIS 제재정보 조회 결과 국가연구개발사업의 제재정보 이력이 없습니다.		

<제출 결과물>